



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月9日

上場会社名 大日本スクリーン製造株式会社
 コード番号 7735 URL <http://www.screen.co.jp/>

上場取引所 東大

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 橋本 正博

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 太田 祐史

TEL 075-414-7155

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	64,551	25.5	6,222	33.8	6,053	31.3	4,720	22.3
23年3月期第1四半期	51,422	97.9	4,650	—	4,612	—	3,859	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 5,053百万円 (728.7%) 23年3月期第1四半期 609百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	19.89	—
23年3月期第1四半期	16.26	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	252,924	91,460	36.0
23年3月期	253,126	87,600	34.4

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 91,011百万円 23年3月期 87,118百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	—	—	5.00	5.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	132,000	19.6	10,500	△4.9	10,000	△8.8	9,000	△6.1	37.91
通期	274,000	7.5	24,000	△10.5	23,000	△13.3	21,000	△18.2	88.47

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

平成24年3月期通期の連結業績予想につきましては、現段階で下半期の事業環境を見極めることが困難なことから、平成23年5月10日公表時の下半期予想を据え置き、上半期の修正のみを反映しております。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
詳細は、「添付資料」4ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	253,974,333 株	23年3月期	253,974,333 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	16,600,150 株	23年3月期	16,598,341 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	237,374,930 株	23年3月期1Q	237,394,439 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成23年5月10日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
3. 当社は、平成23年8月9日(火)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料およびその説明内容は、開催後当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
4. 決算補足資料	12
(1) 連結決算の概要	12
(2) 事業別連結売上高	13
(3) 事業別連結受注状況	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間（平成23年4月1日～6月30日）における世界経済は、中国など新興国の内需拡大を背景に緩やかながら回復基調で推移しました。一方、欧州の金融システム不安や米国の景気減速などにより先行きに不透明感も出てきました。わが国経済は、東日本大震災の影響により混乱していたサプライチェーンの修復が急速に進み、持ち直しの動きも見られましたが、原発事故による電力供給不足が企業活動に影響を及ぼすなど、予断を許さない状況が続きました。

当社を取り巻く事業環境では、半導体業界において、スマートフォンやタブレット型端末などの需要増加を背景に、半導体メーカーの設備投資が堅調に推移しました。しかしながら、足元では半導体製品の需給バランスの悪化を受け、一部半導体メーカーの投資姿勢に慎重な動きが見られるようになりました。

このような状況のなか、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、半導体機器事業が好調に推移し、売上高は645億5千1百万円と前年同期に比べ131億2千8百万円（25.5%）増加しました。利益面では、研究費や人件費などが増加したものの、売上の増加により、営業利益は62億2千2百万円（前年同期比33.8%増）、経常利益は60億5千3百万円（前年同期比31.3%増）となりました。また、特別損失において保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損8億2百万円を計上したことなどにより、四半期純利益は47億2千2百万円（前年同期比22.3%増）となりました。

セグメント別の業績概況は以下のとおりです。

（半導体機器事業：SE）

半導体機器事業では、スマートフォンやタブレット型端末などの需要増加を背景に、半導体メーカーの設備投資が堅調に推移し、洗浄装置を中心に半導体製造装置の売上が前年同期に比べ増加しました。地域別では、アジア向けの売上が引き続き好調に推移したほか、国内、欧米向けも伸長しました。その結果、当セグメントの売上高は482億3千9百万円（前年同期比47.2%増）、営業利益は68億7千5百万円（前年同期比39.3%増）となりました。

（FPD機器事業：FE）

FPD機器事業では、パネルメーカーの設備投資が低調であったため、FPD製造装置の売上が前年同期に比べ減少しました。その結果、当セグメントの売上高は51億円（前年同期比37.9%減）、営業損失は7億2千2百万円（前年同期は6億3千3百万円の営業利益）となりました。

（メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業：MP）

メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業では、印刷関連機器は、国内向けは低調であったものの北米向けにPOD装置が伸び、前年同期に比べ売上が増加しました。プリント配線板関連機器は、関連メーカーの設備投資が堅調に推移し、前年同期に比べ売上が増加しました。その結果、当セグメントの売上高は110億6千8百万円（前年同期比7.4%増）、営業利益は2億1千2百万円（前年同期は9億1千3百万円の営業損失）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は2,529億2千4百万円と前連結会計年度末に比べ2億2百万円（0.1%）の減少となりました。

負債合計は1,614億6千3百万円と前連結会計年度末に比べ40億6千2百万円（2.5%）減少しました。これは主に流動負債において、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したことによるものです。有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べ9億1千5百万円（1.6%）減少し546億7千4百万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、前連結会計年度末に比べ22億7千1百万円（14.6%）減少し133億3千2百万円となりました。

純資産合計は、配当金の支払いにより減少しましたが、四半期純利益の計上などにより、914億6千万円と前連結会計年度末に比べ38億6千万円（4.4%）増加しました。また、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の34.4%から1.6ポイント改善し36.0%となりました。なお、平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本剰余金が255億7千1百万円減少し、利益剰余金が255億7千1百万円増加しております。

（キャッシュ・フローの状況）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少などの収入項目が、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払いなどの支出項目を上回り、45億2千2百万円の収入（前年同期は118億3千3百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、9億2千7百万円の支出（前年同期は3億3千1百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いやリース債務、短期借入金の返済などにより、21億3千3百万円の支出（前年同期は22億6千万円の支出）となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億6千4百万円増加し、396億4千7百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

新興国では内需拡大などを背景に回復基調が続くと見込まれるものの、米国および欧州の一部の国々における財政不安や中国のインフレ懸念、円高傾向で推移する為替など、今後の経済環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社を取り巻く事業環境は、これまで堅調に推移してきた半導体需要に減速の兆しが見られ、半導体メーカーにおいて在庫調整に伴う稼働率低下を背景とした設備投資計画見直しの動きが顕著になるなど、先行きが極めて不透明な状況となりました。このような環境のもと、平成24年3月期の連結業績予想につきましては、上半期において主に半導体機器事業の売上・利益が前回予想を下回ると見込まれることから、平成23年5月10日公表の数値を以下のとおり修正しております。また、通期予想につきましては、現段階で下半期の事業環境を見極めることが困難なことから、下半期の予想を据え置き、上半期の修正のみを反映させております。

[平成24年3月期連結業績予想]

① 第2四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回発表予想（A）	138,000	12,500	12,000	11,000
今回発表予想（B）	132,000	10,500	10,000	9,000
増減額（B－A）	△6,000	△2,000	△2,000	△2,000

② 通期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回発表予想（A）	280,000	26,000	25,000	23,000
今回発表予想（B）	274,000	24,000	23,000	21,000
増減額（B－A）	△6,000	△2,000	△2,000	△2,000

(注) 上記業績予想の前提となる第2四半期以降の為替レートは1米ドル＝80円、1ユーロ＝110円を想定しております。なお、業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、主として当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	39,985	41,341
受取手形及び売掛金	70,979	68,422
商品及び製品	25,307	27,110
仕掛品	31,301	30,900
原材料及び貯蔵品	4,604	4,846
繰延税金資産	7,612	7,554
その他	4,739	4,244
貸倒引当金	△1,007	△1,086
流動資産合計	183,522	183,334
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	53,265	53,265
機械装置及び運搬具	29,019	29,124
その他	28,316	28,947
減価償却累計額	△69,901	△70,718
有形固定資産合計	40,699	40,619
無形固定資産		
その他	1,189	1,203
無形固定資産合計	1,189	1,203
投資その他の資産		
投資有価証券	22,184	22,083
その他	5,601	5,766
貸倒引当金	△71	△84
投資その他の資産合計	27,715	27,766
固定資産合計	69,604	69,589
資産合計	253,126	252,924

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	81,942	80,699
短期借入金	500	2
1年内返済予定の長期借入金	35,060	35,060
1年内償還予定の社債	2,500	2,500
リース債務	2,026	1,909
未払法人税等	2,242	1,287
設備関係支払手形	49	112
役員賞与引当金	68	14
製品保証引当金	6,059	6,117
受注損失引当金	336	296
資産除去債務	32	32
その他	17,313	16,072
流動負債合計	148,131	144,105
固定負債		
社債	7,000	7,000
長期借入金	3,633	3,621
リース債務	4,869	4,579
退職給付引当金	279	341
役員退職慰労引当金	110	119
資産除去債務	48	48
その他	1,453	1,647
固定負債合計	17,394	17,358
負債合計	165,526	161,463
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,044	54,044
資本剰余金	30,154	4,583
利益剰余金	26,418	55,523
自己株式	△12,236	△12,237
株主資本合計	98,381	101,913
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,344	1,852
繰延ヘッジ損益	△41	△41
為替換算調整勘定	△12,566	△12,712
その他の包括利益累計額合計	△11,263	△10,901
少数株主持分	482	448
純資産合計	87,600	91,460
負債純資産合計	253,126	252,924

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	51,422	64,551
売上原価	36,685	46,721
売上総利益	14,737	17,829
販売費及び一般管理費	10,086	11,607
営業利益	4,650	6,222
営業外収益		
受取利息	14	16
受取配当金	148	214
持分法による投資利益	190	—
その他	333	170
営業外収益合計	687	401
営業外費用		
支払利息	459	370
為替差損	112	46
その他	154	153
営業外費用合計	725	570
経常利益	4,612	6,053
特別利益		
貸倒引当金戻入額	81	—
その他	2	0
特別利益合計	84	0
特別損失		
投資有価証券評価損	108	802
災害による損失	—	4
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	297	—
その他	—	0
特別損失合計	406	808
税金等調整前四半期純利益	4,289	5,245
法人税等	468	560
少数株主損益調整前四半期純利益	3,821	4,685
少数株主損失(△)	△37	△35
四半期純利益	3,859	4,720

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,821	4,685
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,074	507
繰延ヘッジ損益	△4	0
為替換算調整勘定	△1,132	△139
その他の包括利益合計	△3,212	367
四半期包括利益	609	5,053
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	640	5,081
少数株主に係る四半期包括利益	△30	△28

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,289	5,245
減価償却費	1,459	1,193
持分法による投資損益(△は益)	△190	0
投資有価証券評価損益(△は益)	108	802
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△86	61
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△13	△53
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△3	58
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△282	△40
受取利息及び受取配当金	△163	△231
支払利息	459	370
売上債権の増減額(△は増加)	4,542	2,813
たな卸資産の増減額(△は増加)	△3,276	△2,193
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△32	582
仕入債務の増減額(△は減少)	6,486	△1,337
未払費用の増減額(△は減少)	△155	△810
その他の流動負債の増減額(△は減少)	56	△718
その他	196	105
小計	13,394	5,848
利息及び配当金の受取額	162	241
利息の支払額	△211	△171
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△868	△57
法人税等の支払額	△643	△1,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,833	4,522
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	3	△43
有形固定資産の取得による支出	△250	△511
有形固定資産の売却による収入	2	0
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	—	3
その他	△84	△372
投資活動によるキャッシュ・フロー	△331	△927
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	△497
長期借入金の返済による支出	△1,112	△12
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,142	△430
自己株式の純増減額(△は増加)	△0	△1
配当金の支払額	—	△1,186
少数株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,260	△2,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	△990	△197
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	8,250	1,264
現金及び現金同等物の期首残高	29,904	38,383
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,154	39,647

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント(注1)				その他 (注2)	合計	調整額 (注3)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注4)
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	32,779	8,210	10,307	51,297	125	51,422	—	51,422
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	1,561	1,561	△1,561	—
計	32,779	8,210	10,307	51,297	1,686	52,983	△1,561	51,422
セグメント利益 又は損失(△)	4,935	633	△913	4,654	52	4,707	△56	4,650

(注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント配線板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

3 セグメント利益又は損失(△)の調整額△56百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント(注1)				その他 (注2)	合計	調整額 (注3)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注4)
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	48,239	5,100	11,068	64,408	142	64,551	—	64,551
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	1,957	1,957	△1,957	—
計	48,239	5,100	11,068	64,408	2,099	66,508	△1,957	64,551
セグメント利益 又は損失(△)	6,875	△720	212	6,367	△40	6,327	△104	6,222

(注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント配線板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

3 セグメント利益又は損失(△)の調整額△104百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本準備金を26,636百万円減少し、その同額を其他資本剰余金に振り替えております。また、増加後の其他資本剰余金を25,571百万円、別途積立金を28,500百万円減少し、それぞれ繰越利益剰余金に振り替えております。この結果、資本剰余金が25,571百万円減少し、利益剰余金が25,571百万円増加しております。

4. 決算補足資料

(1) 連結決算の概要

(百万円未満切捨、その他は単位未満四捨五入)

	23年3月期	24年3月期	対前期比		23年3月期	24年3月期	
	第1四半期実績	第1四半期実績	増減額	増減率	実績	第2四半期 累計期間予想	通期予想
売上高	51,422	64,551	+13,128	+25.5%	254,952	132,000	274,000
営業利益	4,650	6,222	+1,571	+33.8%	26,811	10,500	24,000
(営業利益率)	9.0%	9.6%	+0.6 pt	—	10.5%	8.0%	8.8%
経常利益	4,612	6,053	+1,441	+31.3%	26,531	10,000	23,000
(経常利益率)	9.0%	9.4%	+0.4 pt	—	10.4%	7.6%	8.4%
当期純利益	3,859	4,720	+861	+22.3%	25,686	9,000	21,000
(当期純利益率)	7.5%	7.3%	△0.2 pt	—	10.1%	6.8%	7.7%
総資産	219,107	252,924	★ △202	△0.1%	253,126	—	—
純資産	65,645	91,460	★ +3,860	+4.4%	87,600	—	—
自己資本	65,245	91,011	★ +3,893	+4.5%	87,118	—	—
自己資本比率	29.8%	36.0%	★ +1.6 pt	—	34.4%	—	—
1株当たり純資産	274.84円	383.41円	★ +16.41円	+4.5%	367.00円	—	—
有利子負債	75,366	54,674	★ △915	△1.6%	55,590	—	—
営業キャッシュ・フロー	11,833	4,522	—	—	34,299	—	—
投資キャッシュ・フロー	△331	△927	—	—	△2,191	—	—
財務キャッシュ・フロー	△2,260	△2,133	—	—	△22,249	—	—
減価償却額	1,459	1,193	△265	△18.2%	5,805	2,700	6,200
設備投資額	719	1,192	+473	+65.8%	3,612	3,200	8,400
研究開発費	2,616	2,798	+181	+6.9%	12,129	7,300	15,000
グループ従業員数	4,667人	4,807人	★ +75人	+1.6%	4,732人	—	—
連結子会社数	45社	43社	★ —社	—	43社	—	—
(国内)	(19社)	(19社)	★ (—社)	—	(19社)	—	—
(海外)	(26社)	(24社)	★ (—社)	—	(24社)	—	—
関連会社数	2社	1社	★ —社	—	1社	—	—
(内持分法適用会社数)	(2社)	(1社)	★ (—社)	—	(1社)	—	—

★は対前期末(23年3月期)増減

(2) 事業別連結売上高

(単位：百万円)

		23年3月期					通期実績	24年3月期		
		第1四半期実績	第2四半期実績	第2四半期累計期間実績	第3四半期実績	第4四半期実績		第1四半期実績	第2四半期累計期間予想	通期予想
半導体機器事業	国内	4,857	5,563	10,420	5,351	8,607	24,380	8,668	—	—
	海外	27,922	30,945	58,867	44,156	46,873	149,898	39,571	—	—
	計	32,779	36,509	69,288	49,508	55,481	174,278	48,239	93,500	185,500
FPD機器事業	国内	316	4,031	4,347	864	1,615	6,828	383	—	—
	海外	7,893	5,215	13,109	5,305	7,468	25,882	4,717	—	—
	計	8,210	9,246	17,456	6,170	9,083	32,711	5,100	13,700	39,200
メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業	国内	4,548	6,555	11,104	3,761	5,908	20,773	4,077	—	—
	海外	5,759	6,476	12,236	6,617	7,679	26,532	6,991	—	—
	計	10,307	13,032	23,340	10,378	13,588	47,306	11,068	24,500	48,600
うち印刷関連機器	国内	4,007	5,044	9,051	3,495	4,904	17,452	3,328	—	—
	海外	4,950	5,603	10,553	5,754	6,727	23,035	6,246	—	—
	計	8,958	10,647	19,605	9,250	11,632	40,488	9,574	21,400	42,300
うちプリント配線板関連機器	国内	540	1,511	2,052	265	1,003	3,321	749	—	—
	海外	809	873	1,682	862	951	3,496	744	—	—
	計	1,349	2,385	3,734	1,128	1,955	6,818	1,493	3,100	6,300
その他	国内	122	193	315	151	179	646	138	—	—
	海外	3	1	4	5	0	10	4	—	—
	計	125	194	319	157	179	656	142	300	700
合計	国内	9,844	16,343	26,187	10,128	16,311	52,628	13,267	—	—
	海外	41,578	42,639	84,217	56,084	62,021	202,324	51,284	—	—
	計	51,422	58,982	110,405	66,213	78,333	254,952	64,551	132,000	274,000
	海外比率	80.9%	72.3%	76.3%	84.7%	79.2%	79.4%	79.4%	—	—

(3) 事業別連結受注状況

(単位：百万円)

		23年3月期 第1四半期 (平成22年4月～6月)		23年3月期 第2四半期 (平成22年7月～9月)		23年3月期 第3四半期 (平成22年10月～12月)		23年3月期 第4四半期 (平成23年1月～3月)		24年3月期 第1四半期 (平成23年4月～6月)	
		受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体機器事業	国内	4,638	8,547	4,958	7,941	10,815	13,404	8,275	13,071	10,005	14,407
	海外	47,927	55,358	44,051	68,463	34,571	58,878	45,458	57,462	29,129	47,020
	計	52,565	63,905	49,008	76,404	45,386	72,282	53,732	70,533	39,134	61,427
FPD機器事業	国内	383	3,997	1,658	1,624	1,738	2,497	5,670	6,551	1,129	7,296
	海外	4,787	23,457	7,022	25,263	4,698	24,655	3,808	20,995	5,024	21,301
	計	5,169	27,454	8,680	26,887	6,435	27,152	9,477	27,546	6,152	28,597
メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業	国内	4,788	2,519	5,588	1,551	4,346	2,136	5,852	2,080	3,550	1,552
	海外	6,401	4,086	5,178	2,788	6,427	2,597	7,163	2,080	9,400	4,489
	計	11,189	6,605	10,766	4,339	10,773	4,734	13,015	4,160	12,949	6,041
うち印刷関連機器	国内	4,168	1,436	4,674	1,066	4,158	1,729	4,927	1,751	2,926	1,349
	海外	5,570	3,304	4,635	2,336	5,725	2,307	6,204	1,783	8,371	3,907
	計	9,738	4,740	9,309	3,402	9,884	4,036	11,131	3,534	11,297	5,256
うちプリント配線板関連機器	国内	620	1,083	914	486	188	408	925	329	624	204
	海外	831	782	543	451	702	290	959	297	1,029	581
	計	1,451	1,865	1,457	937	889	698	1,884	627	1,652	785
その他	国内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	海外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	国内	9,809	15,063	12,204	11,117	16,898	18,037	19,796	21,702	14,683	23,256
	海外	59,114	82,901	56,251	96,514	45,696	86,130	56,428	80,537	43,552	72,809
	計	68,923	97,964	68,455	107,630	62,594	104,168	76,224	102,238	58,235	96,065
	海外比率	85.8%	84.6%	82.2%	89.7%	73.0%	82.7%	74.0%	78.8%	74.8%	75.8%